

低溫固化高導熱銀膠技術資料

FeedBond® FP-5300TC-L3

產品說明：

FeedBond®FP-5300TC-L3 為單液型低溫固化環氧樹脂高導熱銀膠接著劑，適用於一般小型半導體晶片、LED 黏著及光通訊產品，應用於高導熱需求。

產品特徵：

- 平滑、流體及無溶劑型之銀膠。
- 適用於一般作業方式如沾膠及點膠作業。
- 在高溫仍維持好的黏著性及高導熱。

硬化前特性		測試條件	測試方法
外觀	銀灰色	目視	目視
比重	5.8	比重計	FT-P001
黏度 @ 25°C	9500cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 @ 25°C	5.5	Brookfield DV-III/CP-51 黏度. @ 0.5rpm/黏度 @ 5rpm	FT-P008
細度	< 25 μ m	細度計	FT-P026
使用壽命 @ 25°C	12 小時	黏度升高 25% @ 5rpm	FT-P002
保存期限 @ -40°C	6 個月		FT-P024 FT-P018
烘烤條件		測試條件	測試方法
標準烘烤條件		60 分鐘 @130°C (烘箱烘烤)	
機械性質		測試條件	測試方法
晶片推力 @ 25°C	>2 Kg/die	晶片尺寸 45mil × 45mil (銀支架)	FT-M012

註:此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

FeedBond® FP-5300TC-L3

物理及化學性質		測試條件	測試方法
玻璃轉移溫度 (Tg)	120°C	DMA (TA) 阻尼峰, 三點彎曲模式	FT-M014A
熱重損失 @200°C	<0.2%	TGA	FT-P010
@300°C	<1.0%		
熱膨脹係數 <Tg	59 ppm/°C	TMA 膨脹模式	FT-M016
>Tg	168 ppm/°C		
儲存模數			
@25°C	8816 MPa	DMA(TA), 試片厚度<1.6mm	FT-M019A
@150°C	1460 MPa		
@250°C	784 MPa		
熱/電性質		測試條件	測試方法
體積電阻	<0.0005Ω · cm	四點探針	FT-P017
熱傳導係數	20W/mK	Hot Disk	FT-P022

註:此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

運用指導方針

運輸

運送過程皆放入乾冰或低溫冰袋等低溫保存並放置溫度指示劑以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無乾冰殘留（或溫度指示劑呈現液態），請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

解凍處理

解凍時，請將針筒（瓶、罐）直立解凍，直到完全達室溫時才能使用(回溫時間30~90鐘)，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

儲存條件

當您收到貨品時，請立即以低溫（-20°C 或 -40°C）儲存。由於不同溫度下之保存將影響產品的壽命（保存溫度與產品壽命成正比）

儲存溫度	-35°C ~ -42°C	-18°C ~ -22°C	0°C ~ 5°C	18°C ~ 28°C
保存期限	6 個月	3 個月	1 個月	2 天